

中信证券股份有限公司
关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 14 日—15 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 经营风险

1、规模增长带来的管理风险

公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，与之相匹配的离散型制造模式对公司的管理能力要求较高。公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，管理、技术和生产人员数量持续增加，且海内外战略布局存在的跨区域生产等均对公司的管理层和内部管理水平提出了更高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

2、产能储备与市场开发错配的风险

近年来，半导体设备市场周期性波动态势给公司带来相应的经营风险。在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，对相关设备的采购需求增多；在行业景气度下降过程中，产业则可能削减资本支出，进而对设备的采购需求有

所下降。公司在报告期内提前储备北京、新加坡产能但存在订单不及预期，短期内导致折旧增加，利润承压的风险。

3、公司研发不能紧跟工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险

遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的规律，半导体设备和半导体设备精密零部件必须紧跟下游需求不断研发升级。目前晶圆制造和半导体设备已向 7 纳米及更先进的工艺制程演进，对公司的研发能力不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级产品，提高晶圆制造效率，公司须及时研发相匹配的精密零部件或对原有产品持续优化。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

（二）财务风险

1、毛利率波动风险

报告期内，公司产品毛利率为 25.80%，受半导体行业技术迭代、行业景气度、产能预投节奏、地缘政治和原材料价格波动等多种因素影响，存在波动风险，具体包括但不限于：

（1）半导体设备行业与宏观经济和半导体行业密切相关，且周期波动性更强，宏观经济和行业景气度和公司订单、收入和产能利用率呈正比；

（2）公司为资本及技术密集型企业，考虑到建设周期，通常需预投产能以满足未来市场需求。若公司产能达产节奏与行业景气度错配，产能利用率和毛利率波动将进一步放大；

（3）若公司主要出口国家或地区与中国贸易关系恶化，主要出口国家或地区客户可能削减公司订单或寻找非中国大陆的替代供应商。

2、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 119,559.90 万元，占总资产的比例为 14.31%，公司应收账款周转率为 3.08。随着零部件国产化的不断推进，国内半导体厂商崛起，回款周期较长的大陆地区客户收入和占比持续提升，如未来公司应

收账款增长速度过快、主要客户付款周期延长，付款方式发生变化，公司应收账款周转率可能下降，继而可能对公司业绩造成不利影响。

3、存货增加导致的风险

报告期内，公司存货账面价值为 89,985.75 万元，占总资产的比例 10.77%，公司存货周转率为 2.50。公司存货水平受产品结构、市场需求关系、供需关系、生产计划与供应链管理、外部环境等因素共同影响。报告期内，公司存货中，原材料占比为 40.16%，库存商品占比为 19.98%。如未来公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

4、财政补助政策变动的风险

报告期内，公司确认为当期非经常性损益的政府补助为 3,984.28 万元，占当年利润总额比例为 20.70%。若未来政策环境发生变化，公司可能无法持续获得政府补助。

5、汇率风险

报告期内，公司汇兑损益为-920.84 万元。人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率的影响程度。

（三）行业风险

如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致 5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，半导体设备厂商、晶圆厂将面临产能过剩的局面，继而大幅削减资本性支出，最终大幅影响公司收入。由于公司为资本及技术密集型企业，资本及持续研发投入较大，若订单和产能利用率大幅下滑，公司业绩亦可能大幅下滑。

全球半导体设备市场由国际厂商主导，与之配套的半导体设备精密零部件制造商主要为美国、日本和中国台湾地区的上市公司。与国际同业相比，公司业务规模较小，资金实力较弱。基于半导体设备精密零部件行业资本及技术密集的特

点，若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力，在行业全球化竞争中，可能导致公司市场竞争力下降、经营业绩下滑。

（四）宏观环境风险

1、宏观经济变化的风险

公司的经营业务与下游行业及宏观经济周期密切相关。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

2、国际贸易摩擦升级的风险

近年来，国际政治经济环境风云变幻，国际贸易摩擦不断升级，全球地缘安全和经济发展将面临更大的不确定性。如果国际贸易政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒进一步恶化，将可能影响公司出口业务。

公司目前主要出口地为美国、新加坡、马来西亚、日本、中国台湾等。外销业务受前述国家或地区的政治经济环境影响较大。若国内提高进口关税、该等国家或地区提高出口关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司产品进出口产生不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	303,956.79	206,575.59	47.14
归属于上市公司股东的净利润	20,264.98	16,868.79	20.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,190.34	8,639.02	98.98
经营活动产生的现金流	-5,214.84	-38,638.18	不适用

量净额			
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	458,817.42	456,485.55	0.51
总资产	835,655.97	758,986.39	10.10
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.41	63.41
加权平均净资产收益率(%)	4.46	3.61	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.78	1.85	增加1.93个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	7.28	9.97	减少2.69个百分点

1、营业收入增长

2024 年度公司实现营业收入 303,956.79 万元，同比增长 47.14%，主要受益于全球半导体市场需求持续释放及半导体产业链国产化进程加速。

分区域看：来自中国大陆地区收入为 206,672.38 万元，同比增长 43.95%，占主营业务收入的比重为 69.75%。来自中国大陆以外地区收入为 89,652.19 万元，同比增长 48.98%，占主营业务收入的比重为 30.25%。

分产品类别：机械及机电零组件产品收入 208,407.16 万元，同比增长 57.69%，成为核心增长引擎。气体传输系统产品收入 87,917.41 万元，同比增长 22.82%，第二增长曲线保持稳步提升。

2、盈利能力提升

报告期内实现扣非归母净利润 17,190.34 万元，同比增长 98.98%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 63.41%，主要系规模效益显现，高附加值产品放量，有效摊薄设备折旧等固定成本；国内生产基地产能效率提升。

3、现金流管理优化

经营活动现金流净额为-5,214.84 万元，较上年同期收窄，主要系公司持续优化管理经营性现金流，客户回款情况较好，且存货管理提升，存货周转次数增长。但是由于账期较长的境内收入占比增长，且回款方式存在票据回款，经营性现金流呈现负值。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、与国内外主要半导体设备厂商建立了长期稳定的合作关系

目前，公司已进入的客户供应链体系既包括国际知名半导体龙头设备商，又包括国内主流半导体设备厂商。由于半导体设备厂商对所选用的精密零部件要求极为苛刻，一旦确定合作关系往往长期深度绑定；同时，一旦通过全球主流设备厂家认证，行业内其他厂家会相继跟进与其开展合作，因此公司的客户基础为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障。

同时，公司基于自身战略布局并为响应客户需求，在海外扩建产能，设立全资子公司，积极推动与海外客户共建稳定合作关系。公司设立境外全资子公司是基于公司战略发展规划的考虑，符合国家政策，有利于进一步扩大公司国际业务规模，拓宽公司产品线，保持技术领先性，增强公司盈利水平，深化公司与国际客户之间的黏性，提高全球供应链采购能力，有效提升国际市场工艺、产品、质量优势。

2、多种制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能

半导体设备精密零部件行业所需的资本和研发投入门槛较高，各家均有独特的生产 Know-How，行业内大多数企业只专注于个别工艺技术，或特定零部件产品，而公司已形成了达到全球半导体设备龙头企业标准的多种制造工艺和产能。

公司多种的制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能有利于客户降低供应链成本、提升采购效率，使得双方合作关系更加紧密。

3、离散型制造企业柔性化、智能化管理优势

在离散型制造模式的深度实践中，公司提炼出"标准化工艺库+智能化决策"

的复合型制造范式，破解了多品种、小批量、定制化生产中的动态平衡难题。通过构建半导体精密零部件共性技术平台，基于工艺知识库实现复杂首件的模块化拆解，突破传统人工经验依赖，并在关键工序嵌入智能判异系统，形成工艺参数自优化的闭环控制。针对复杂装配场景，首创智能设计平台，实现核心结构的功能导向型自主生成，保证产品质量的稳定与生产效率的提高。

4、全链条体系化能力优势

公司自 2011 年起基于与国际龙头客户的深度协同需求，启动供应链体系化建设，先后通过 SSQA 质量体系审核及覆盖 36 个模块的 SPACA 认证（涵盖生产制造、内部审计、工程能力、人力资源管理、知识产权保护、采购管理、计划调度及质量管控全流程）。通过持续对接国际客户标准，公司已形成覆盖全价值链的一站式制造能力，构建起行业领先的流程管控优势，能够满足全球半导体设备领域对精密零部件制造的系统化、标准化及可追溯性要求。

5、全球化布局优势

公司通过“本土化+区域协同”战略实现高效资源配置，覆盖全球关键市场。境内以沈阳为核心枢纽，匹配国内京津冀、长三角、珠三角，打造智能制造基地；境外在美国、新加坡布局前瞻性产能节点，有效规避贸易壁垒并贴近终端需求。新加坡富创自 2023 年启动建设以来，截至本公告披露日已完成核心客户 A1 公司认证并实现接单，同时 A2 客户的认证已完成审核。随着新加坡子公司产能的逐步释放，其本土化生产将直接对接海外市场，同时在行业政策波动情况下，新加坡富创作为开展国际业务的主体，其供应链成本竞争力得到显著提升，将进一步增强公司与友商的竞争壁垒，为公司构建全球化供应链新格局奠定战略支点。

除此外，公司还将通过投资产业链上下游优秀标的，实现垂直产业链各环节的研发与制造协同，增强全球竞争力，加速实现零部件平台化业务布局。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出变化

单位：万元

项目	2024 年度	2024 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	22,139.81	20,601.63	7.47
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	22,139.81	20,601.63	7.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.28	9.97	减少 2.69 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

公司持续加大研发投入，2024 年度，公司研发投入为 22,139.81 万元，同比增加 7.47%。

(二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能涂层工艺开发项目	20,228.56	5,734.29	12,468.67	持续研发	1、突破热喷涂与原子层沉积复合工艺体系，实现腔体、内衬、匀气盘等半导体设备核心部件的精密涂层制备，完成半导体设备关键部件用高致密、高耐腐蚀、高洁净度氧化钼涂层制备技术研究及主要攻关指标；2、完成产品清洗标准制定；3、开发出高反射镀金工艺，制作镀金标准工艺制程规范；	国内领先	可应用于刻蚀、CVD、ALD、PECVD 等关键制程设备中核心零件
2	核心功能部件开发项目	37,851.31	10,423.34	23,680.30	持续研发	1、攻克精孔高粗糙度要求、台阶异形孔精密加工技术、不锈钢金属高耐腐蚀性技术要求；标准化操作、刀具管控等工艺标准开发；设计开发自动化产线；2、建立设计及制造高精度气路阀组件的能	国内领先	可应用于刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光等设备。

						力，建立测试能力及平台；3、实现集成电路化学机械抛光设备中保持环零部件产品的国产化开发；		
3	精密机械制造工艺优化项目	8,813.31	2,948.23	3,321.51	持续研发	1、打造专线制造模式，提高制造效率，降低制造成本 2、建立复杂多层结构气盘、热盘类焊接制造能力，实现关键核心零部件的国产化替代；3、实现刀具管理数字化建设，先进设备性能与刀具性能的双高效输出，降本增效。	国内领先	生产制造领域
4	气体传输系统工艺技术开发项目	4,546.96	3,033.95	4,268.55	持续研发	通过定制开发专属制造设备和信息化系统实现切割、折弯、清洗、气柜组装、气柜测试的自动化生产，实现重点制造工序的全自动监控，确保信息全流程可追溯性。	国内领先	应用于 ETCH、CVD、ALD 等关键制程设备中 VCR 及 IGS 类型的气体传输系统
合计	/	71,440.13	22,139.81	43,739.03	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持股不存在质押、冻结及减持情况，持股变化情况具体如下：

单位：股

名称	身份/职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
沈阳先进制造技术产业有限公司	第一大股东	不适用	不适用	35,349,500	52,317,260	16,967,760	公司权益分派实施
郑广文	实际控制人、董事长、总经理（已离任）	2020/10/10	2026/10/24	10,000,000	14,819,678	4,819,678	公司权益分派实施及股权激励归属
李赓	董事	2020/10/10	2026/10/24	0	0	0	不适用
齐雷	董事	2020/10/10	2026/10/24	0	0	0	不适用
倪世文	董事、副总经理、核心技术人员	2020/10/10	2026/10/24	0	14,740	14,740	股权激励归属
宋洋	董事、副总经理	2023/10/24	2026/10/24	0	5,896	5,896	股权激励归属
梁倩倩	董事、董事会秘书	2023/10/24	2026/10/24	0	3,445	3,445	股权激励归属
朱煜	独立董事	2020/10/10	2026/10/10	0	0	0	不适用
傅穹	独立董事	2023/10/24	2026/10/24	0	0	0	不适用
何燎原	独立董事	2023/10/24	2026/10/24	0	0	0	不适用
刘明	监事会主席	2023/10/24	2026/10/24	0	0	0	不适用
刘臻	监事	2023/10/24	2026/10/24	0	0	0	不适用
蔡润一	职工代表监	2020/10/10	2026/10/24	0	0	0	不适用

	事						
张璇	总经理	2024/8/16	2026/10/24	0	0	0	不适用
陈悉遥	副总经理	2020/10/10	2026/10/24	0	9,839	9,839	股权激励归属
宋岩松	副总经理、 核心技术人员	2020/10/10	2026/10/24	0	6,890	6,890	股权激励归属
崔静	财务总监	2024/8/16	2026/10/24	0	0	0	不适用
杨爽	财务总监 (已离任)	2020/10/10	2024/8/16	0	3,942	3,942	股权激励归属
合计	/	/	/	45,349,500	67,181,690	21,832,190	/

注：上表中与“持股数”相关均为直接持股数量，不包括间接持股。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

（一）关于与 A 公司的关联交易情况

公司自 2023 年 2 月与 A 公司发生交易购买产品，A 公司实为公司关联方，上述交易构成关联交易。公司未对相关交易及时审议并披露。

前述交易系基于商业合作安排，A 公司协助公司对部分物料进行采购，公司于 2023 年 2 月起与 A 公司发生交易。鉴于公司实控人郑广文先生曾为 A 公司股东提供资金支持，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）项规定的“实质重于形式”并根据谨慎性原则，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议《关于新增对外投资暨关联交易的议案》，追认 A 公司与公司构成关联关系，A 公司为公司关联法人，并将 2023 年、2024 年 1 月 1 日至本公告披露日 A 公司与公司发生的交易事项追认为关联交易。2023 年度公司向 A 公司购买产品、商品金额为 3,559.65 万元(不含税)，2024 年预计不超过 2,897.63 万(不含税)，占年度同类业务占比约 2.14%。

公司于 2025 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下达的行政监管措施决定书《关于对沈阳富创精密设备股份有限公司及郑广文、张璇、杨爽、崔静、梁倩倩采取出具警示函措施的决定》（（2025）4 号）（以下简称“决定书”），根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）对公司及董事长郑广文、总经理张璇、时任财务总监杨爽、

现任财务总监崔静、董事会秘书梁倩倩采取出具警示函的行政监管措施。并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应完善内部控制，对信息披露工作进行全面自查，对相关错报及时全面进行更正，充分吸取教训，提高信息披露质量，杜绝此类事项再次发生。公司应自收到本决定之日起 30 日内完成整改并向辽宁证监局提交书面整改报告。

公司及相关人员收到上述决定书后，高度重视上述问题，并严格按照决定书的要求对存在的问题进行整改，按时提交相关整改报告。

（二）关于实际控制人所持第一大股东部分股权被冻结的情况

沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）为公司第一大股东，注册资本为 1,750.00 万元，其中公司实际控制人郑广文先生直接持有 1,450.00 万元出资额，郑广文先生控制的沈阳天广投资有限公司直接持有 300.00 万元出资额，郑广文先生合计控制沈阳先进 100%股权。截至 2025 年 3 月 31 日，沈阳先进持有公司 5,231.73 万股，占公司总股本的 17.09%。根据国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询，郑广文先生直接持有的公司第一大股东沈阳先进 831.17 万元出资额被北京市监察委员会冻结（京监冻(2024)130003 号），冻结期限自 2024 年 6 月 6 日起至 2025 年 6 月 6 日止。

经公司自查及根据郑广文先生的说明，郑广文先生所持沈阳先进部分股权冻结事项与公司生产经营和公司治理无关，郑广文先生目前正常参与公司生产经营并履行董事长职责；沈阳先进为实际控制人郑广文先生投资半导体产业的控股平台，公司与沈阳先进在资产、人员、财务、机构、业务、资金等方面均保持独立。针对上述股权事项，郑广文先生正在与北京市监察委员会等相关方积极磋商，争取早日解除其持有的部分沈阳先进股权的冻结。

除前述情况外，基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。保荐人提示广大投资人关注投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

张欢

张 欢

张明慧

张明慧

